

## 附件 1

## 重点领域任务方向表

序号	细分领域	任务方向（可补充）	备注
1	芯片设计与制造	高端芯片及新结构、新原理集成电路 先进制造工艺 先进封测技术 关键核心装备及零部件 集成电路用高端材料 ……（可补充）	
2	通信与网络	6G 通信技术与关键器件 空天地海通信技术与网络 光通信技术与网络 关键核心装备及零部件 ……（可补充）	
3	软件与信息 安全	操作系统 信息安全 区块链 人工智能赋能技术 专用软件 ……（可补充）	
4	新一代人工 智能	智能算力硬件 模型算法 数据处理 具身智能 AI for Science 人形机器人 创新应用 ……（可补充）	
5	新型储能与 新能源	氢能 风能 太阳能 核能 生物质能 海洋能 地热能	

序号	细分领域	任务方向（可补充）	备注
		新型储能 储能装备及技术 能源电子及智慧电网 ……（可补充）	
6	重点新材料	金属材料（特种钢铁材料、铜基材料、稀土材料、磁性材料、合金材料等） 非金属材料（玻璃材料、陶瓷材料、半导体材料等） 高分子材料（化工材料、聚酯材料、高性能纤维材料、弹性体材料、涂层材料等） 复合材料（纤维增强复合材料，颗粒增强复合材料，层状复合材料，功能复合材料等） 未来材料（仿生智能材料、纳米材料、超导材料等） 材料共性技术（材料基因工程、生物制造技术、材料全生命周期设计与评价等） ……（可补充）	